

e-Link与e-LinkPro2及其衍生产品 比较说明



OUTLINE

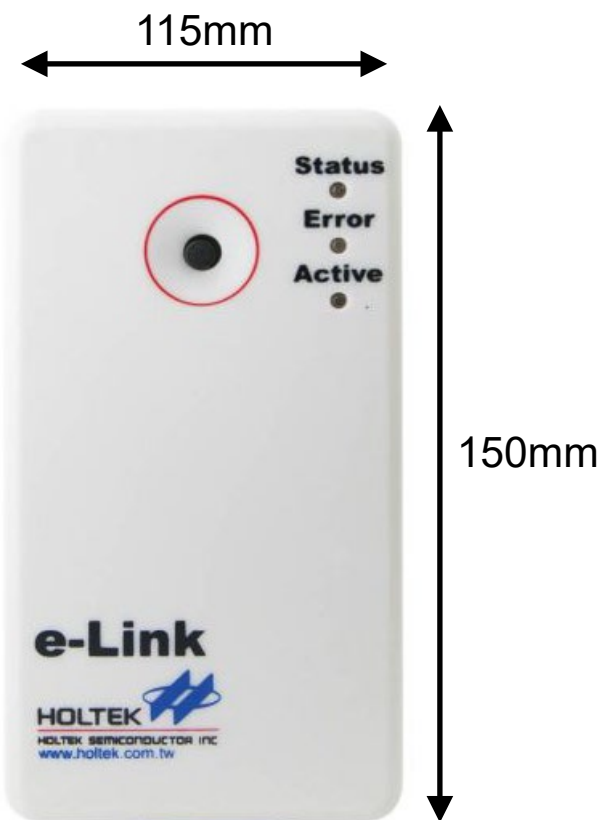
1. 硬件差异比较
2. 应用软件与应用场景



硬件差异比较



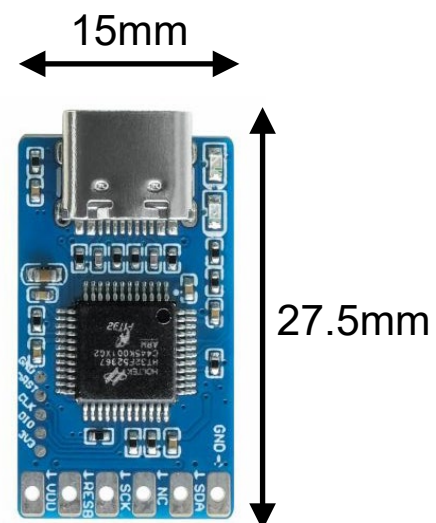
硬件外观/配件(1/3)



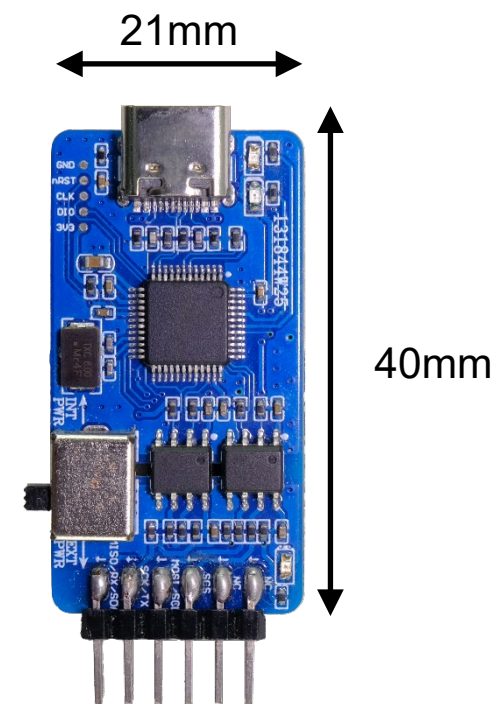
e-Link



e-LinkPro2

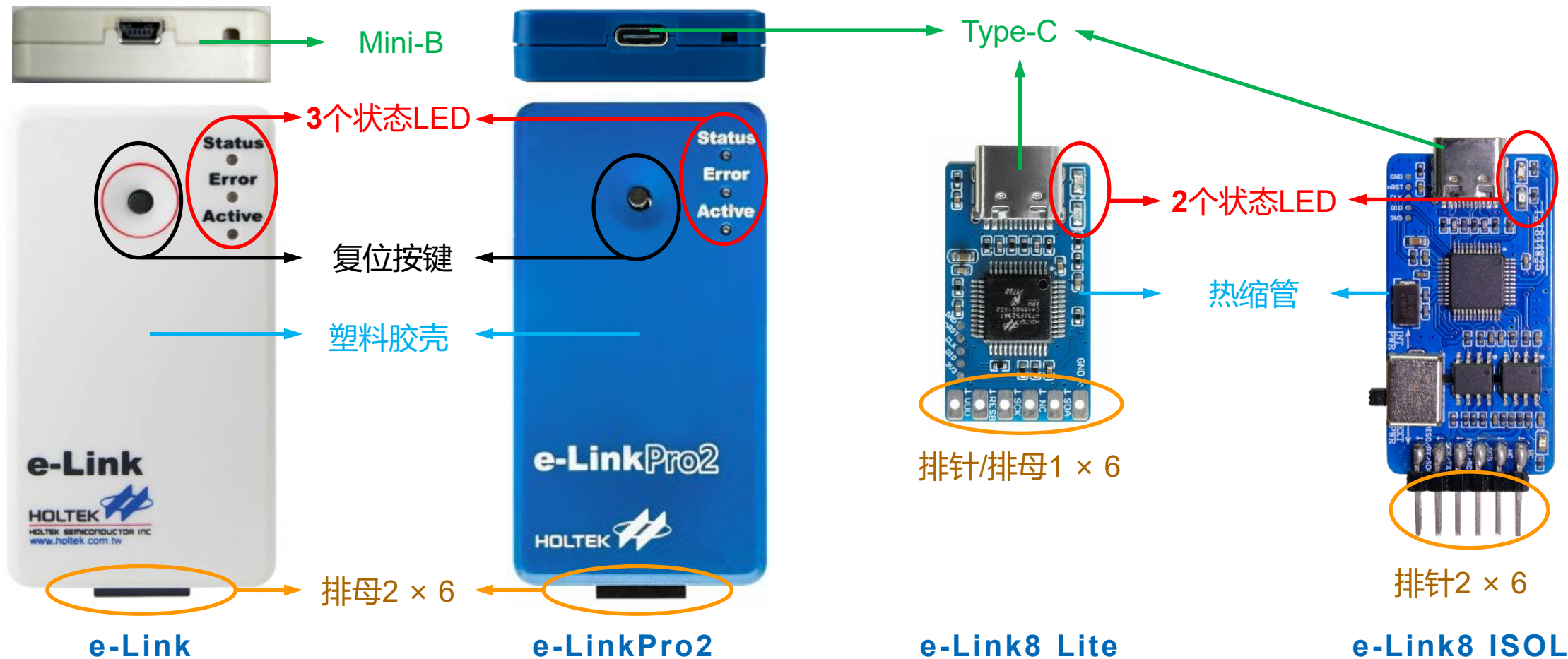


e-Link8 Lite



e-Link8 ISOL

硬件外观/配件(2/3)





硬件外观/配件(3/3)



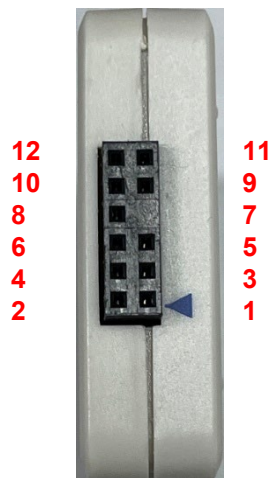
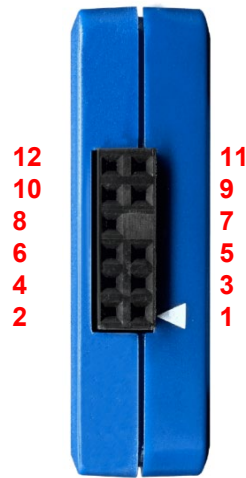
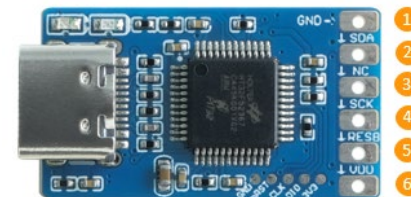
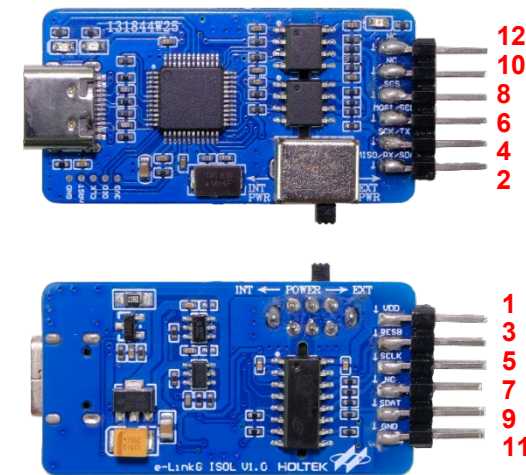
e-Link



e-LinkPro2



硬件接口



12: 5V	11: GND
10: NC	9: ICPDA / OCDSDA
8: CS	7: NC
6: MOSI / SCL	5: ICPCCK / OCDSCK
4: SCK / TX	3: RESB / NC
2: MISO / RX / SDA	1: VDD

e-Link

12: VPP	11: GND
10: NC	9: ICPDA / OCDSDA
8: CS	7: NC
6: MOSI / SCL	5: ICPCCK / OCDSCK
4: SCK / TX	3: RESB / NC
2: MISO / RX / SDA	1: VDD

e-LinkPro2

1: GND
2: ICPDA / OCDSDA
3: NC
4: ICPCCK / OCDSCK
5: RESB / NC
6: VDD

e-Link8 Lite

12: NC	11: GND
10: NC	9: ICPDA / OCDSDA
8: CS	7: NC
6: MOSI / SCL	5: ICPCCK / OCDSCK
4: SCK / TX	3: RESB / NC
2: MISO / RX / SDA	1: VDD

e-Link8 ISOL



硬件功能参数

Part No.	e-Link	e-LinkPro2	e-Link8 Lite	e-Link8 ISOL	Note
EXT. SPI Flash ROM	32M b (SPI)	256M b (QSPI)	×	×	
USB接口	Mini-B	Type-C	Type-C	Type-C	均为USB 2.0 Full speed
INT. VDD	1.7V ~ 5.5V	1.5V ~ 5.5V	3.3/5V	3.3/5V	
INT. VDD供电电流	@5V/210mA	@5V/210mA	@5V/400mA	@5V/400mA	取决于USB接口驱动能力
EXT. VDD	√	√	√	√	
VPP	×	5V ~ 12V	×	×	
Pinout	ICP/OCDS×1 UART×1 SPI×1 I²C×1	ICP/OCDS×1 UART×1 SPI×1 I²C×1	ICP/OCDS×1	ICP/OCDS×1 UART×1 SPI×1 I²C×1	
隔离	Level shift	Level shift	Level shift	容耦隔离	完全的电气隔离
Interface	2 × 6	2 × 6	1 × 6	2 × 6	
USB Bridge	×	UART/SPI/I²C	×	UART/SPI/I²C	
在线仿真	HT8 Flash	HT8 Flash/OTP	HT8 Flash	HT8 Flash	
在线烧录	HT8 Flash	HT8 Flash/OTP	HT8 Flash	HT8 Flash	
离线烧录	√	√	×	×	



应用软件与应用场景

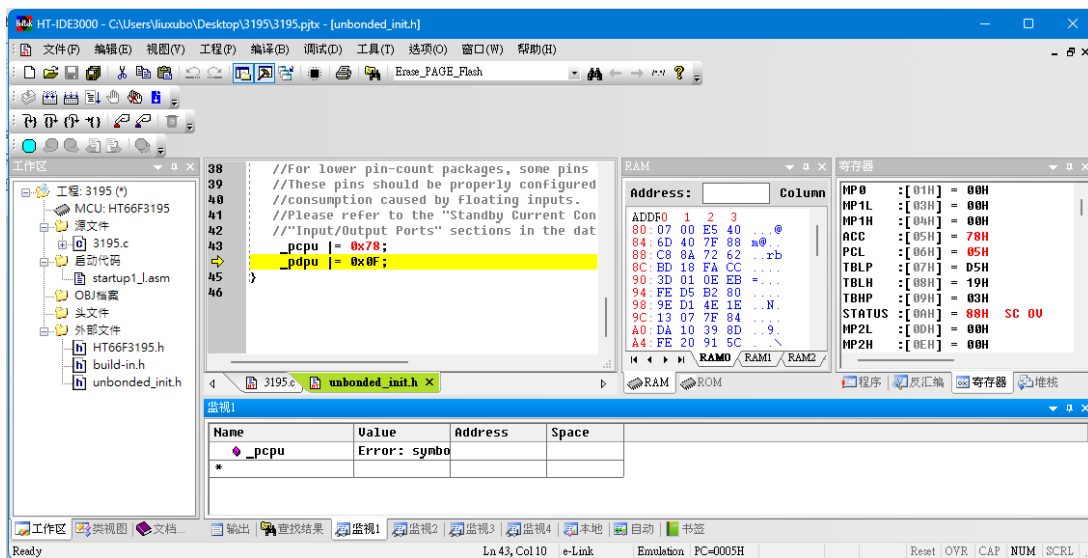
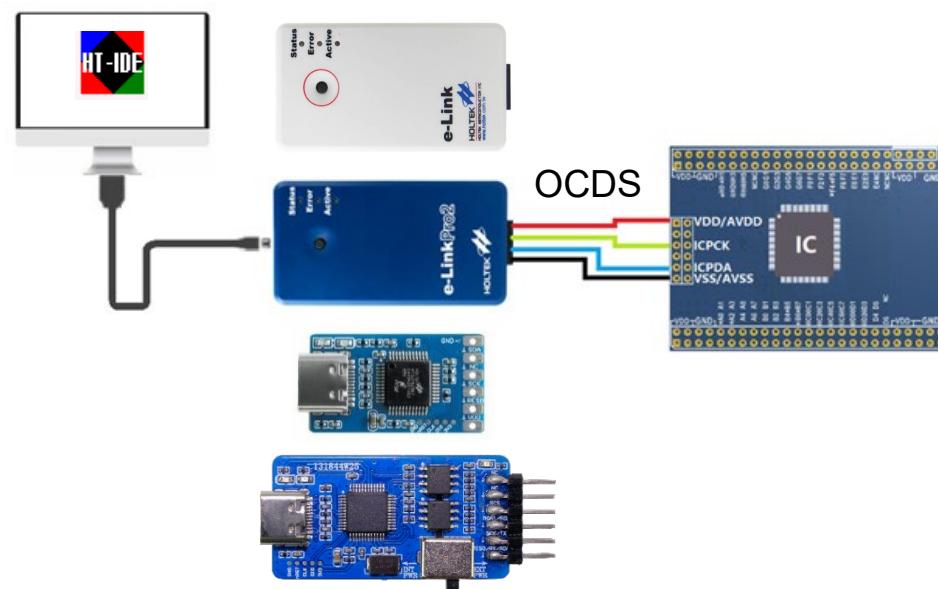


应用软件

Part No.	e-Link	e-LinkPro2	e-Link8 Lite	e-Link8 ISOL
HT-IDE3000	在线仿真/烧录	在线仿真/烧录	在线仿真/烧录	在线仿真/烧录
HOPE3000 for e-Link	在线烧录	在线烧录	在线烧录	不支持
HOPE5000	不支持	在线/离线烧录	不支持	不支持
USB Bridge Tool	不支持	UART/SPI/I ² C	不支持	不支持
Voice Workshop	SPI Flash烧录 语音系列MCU烧录	SPI Flash烧录 语音系列MCU烧录	不支持	不支持
Touch Workshop & HTouch	BS系列MCU烧录	BS系列MCU烧录	不支持	BS系列MCU烧录 UART/I ² C通信调试
LED Workshop	SPI Flash烧录 HT8 MCU烧录	SPI Flash烧录 HT8 MCU烧录	不支持	不支持

应用场景：在线OCDS仿真

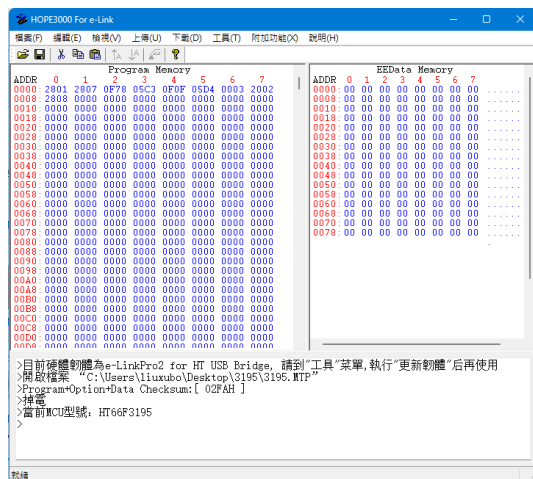
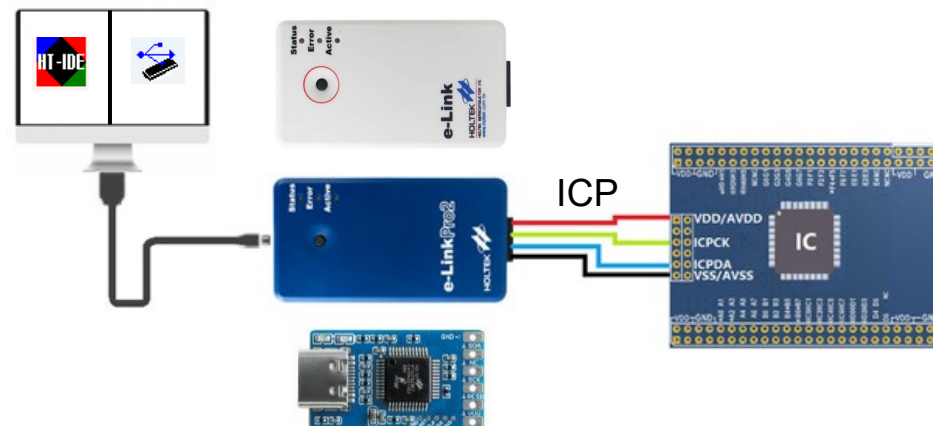
e-Link、e-LinkPro2、e-Link8 Lite、e-Link8 ISOL支持在HT-IDE3000下进行在线OCDS仿真功能，编程时可对HT8 MCU进行多功能追踪、单步执行、设定断点、观察变量/SFR等。





应用场景：在线ICP烧录(1/2)

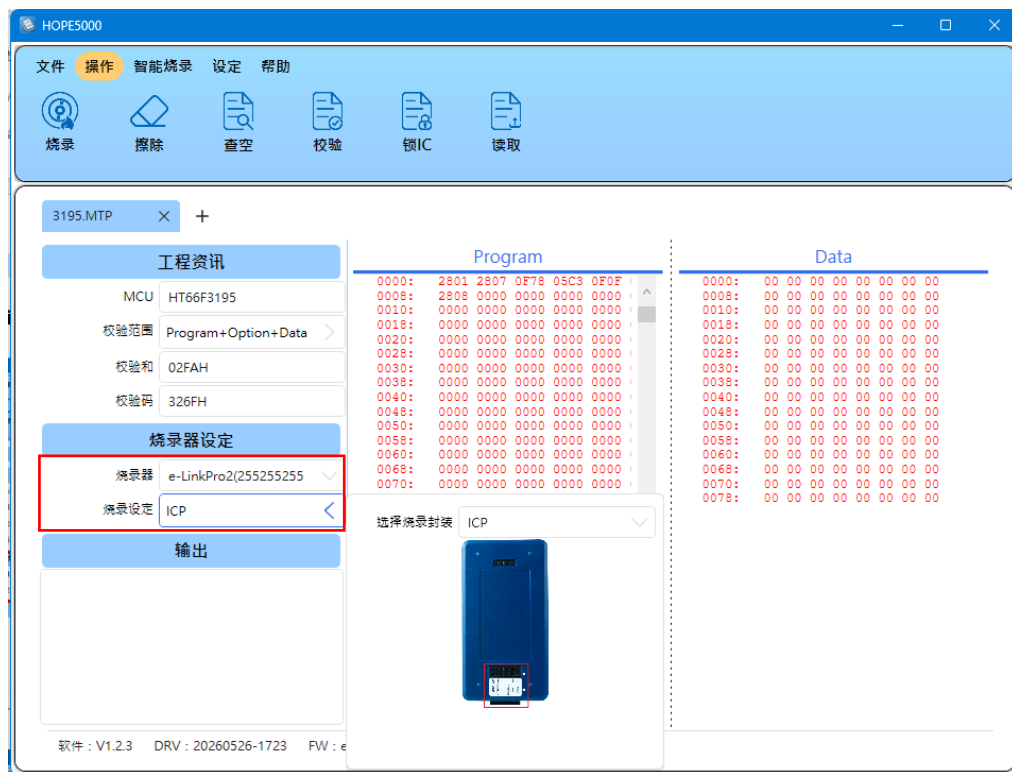
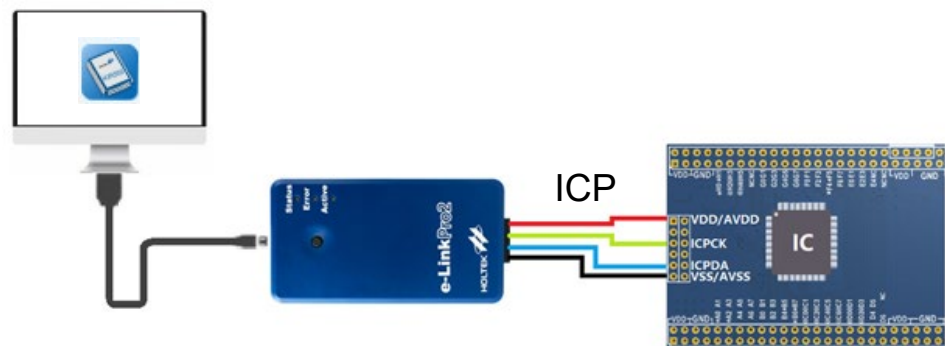
e-Link、e-LinkPro2、e-Link8 Lite支持在HT-IDE3000、HOPE3000 for e-Link下进行在线ICP烧录。





应用场景：在线ICP烧录(2/2)

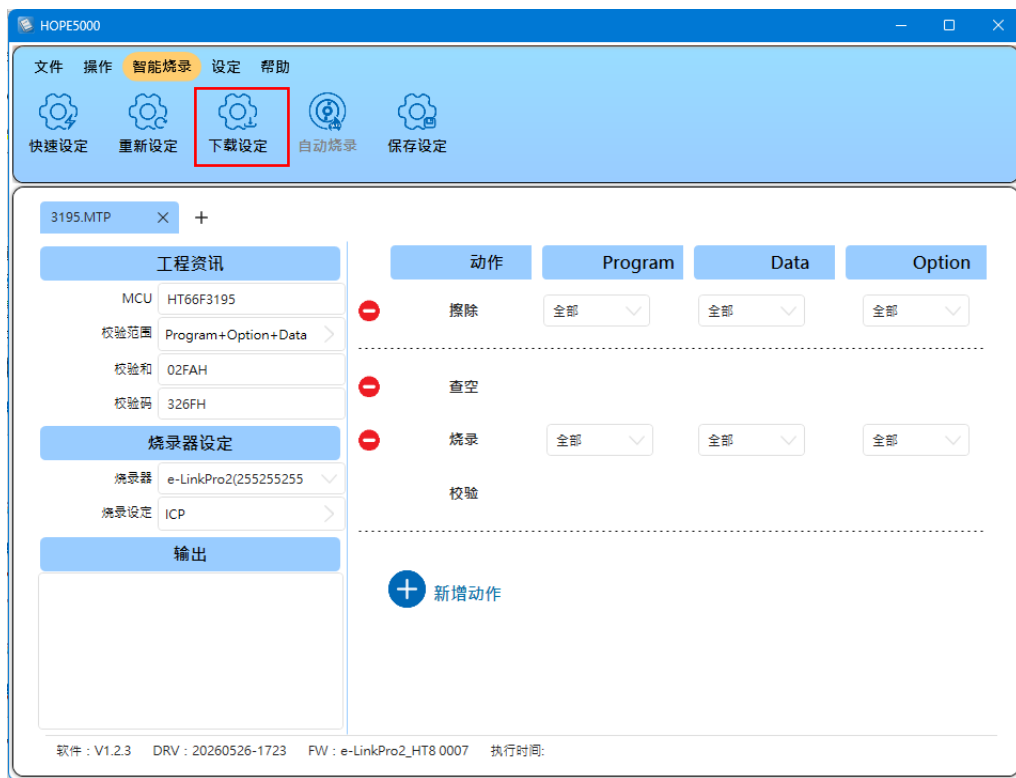
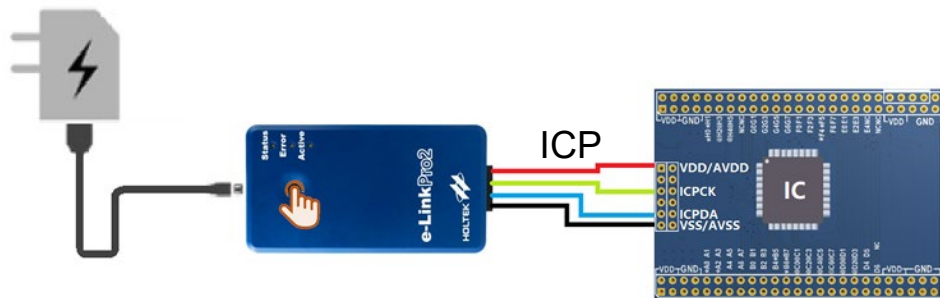
e-LinkPro2还支持在HOPE5000下进行在线ICP烧录。





应用场景：离线烧录

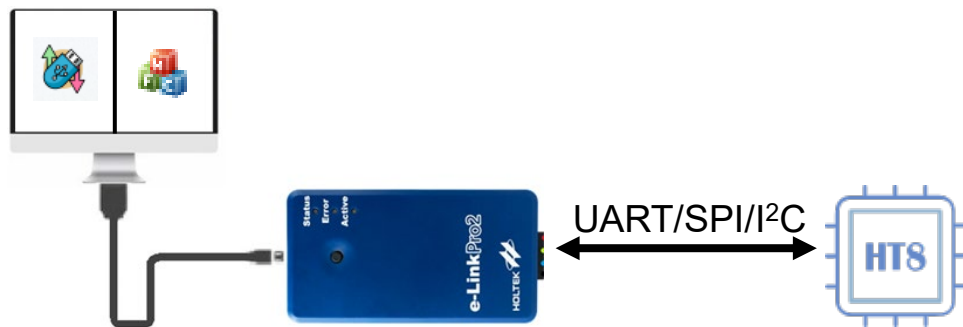
e-LinkPro2支持离线烧录功能，在HOPE5000执行完**文件下载**之后，接通电源(5V/3A)，便可脱离上位机执行离线烧录。





应用场景：USB Bridge、在线IAP烧录

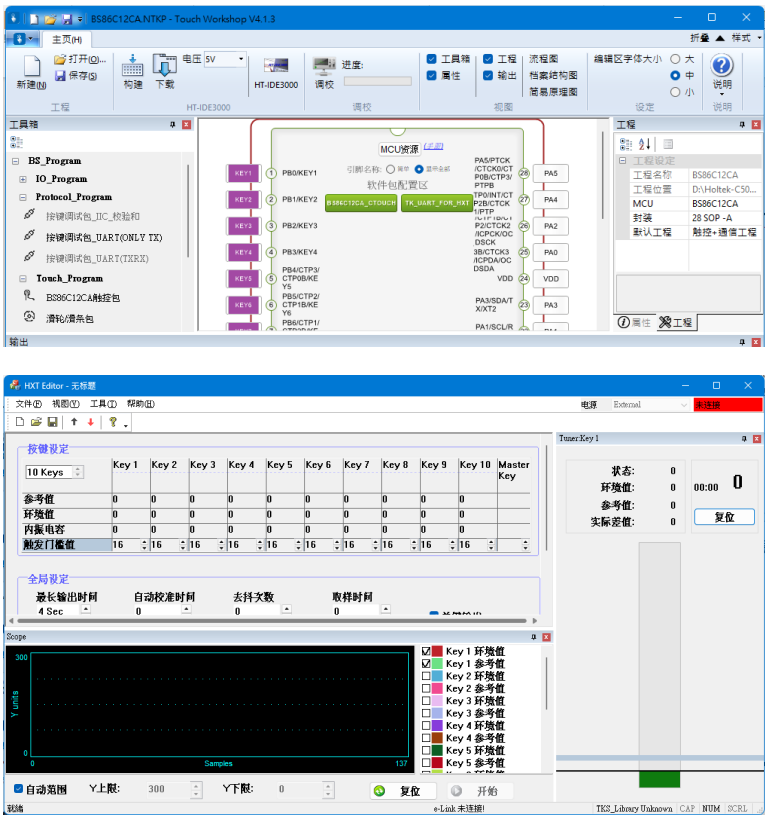
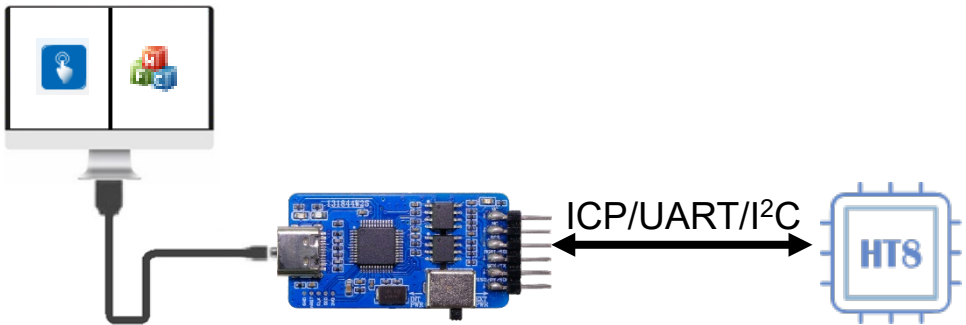
e-LinkPro2支持在USB Bridge Tool下进行USB to UART/SPI/I²C通信，帮助快速开发通信协议。基于USB Bridge，e-LinkPro2还可支持在HT8 IAP下执行在线IAP烧录功能。





应用场景：隔离外部高压电源、信号

e-Link8 ISOL具有隔离外部高压电源、信号的功能，满足在市电等高压环境下与目标IC建立起USB to UART/SPI/I²C通信，可支持在**Touch Workshop & HTouch**下对BS系列MCU的ICP烧录、UART/I²C通信。





Copyright© 2026 by HOLTEK SEMICONDUCTOR INC. All Rights Reserved.

本文件出版时HOLTEK已针对所载信息为合理注意，但不保证信息准确无误。文中提到的信息仅是提供作为参考，且可能被更新取代。HOLTEK不担保任何明示、默示或法定的，包括但不限于适合商品化、令人满意的质量、规格、特性、功能与特定用途、不侵害第三方权利等保证责任。HOLTEK就文中提到的信息及该信息之应用，不承担任何法律责任。此外，HOLTEK并不推荐将HOLTEK的产品使用在会由于故障或其他原因而可能会对人身安全造成危害的地方。HOLTEK特此声明，不授权将产品使用于救生、维生或安全关键零部件。在救生/维生或安全应用中使用HOLTEK产品的风险完全由买方承担，如因该等使用导致HOLTEK遭受损害、索赔、诉讼或产生费用，买方同意出面进行辩护、赔偿并使HOLTEK免受损害。HOLTEK(及其授权方，如适用)拥有本文件所提供信息(包括但不限于内容、数据、示例、材料、图形、商标)的知识产权，且该信息受著作权法和其他知识产权法的保护。HOLTEK在此并未明示或暗示授予任何知识产权。HOLTEK拥有不事先通知而修改本文件所载信息的权利。如欲取得最新的信息，请与我们联系。